LAGENAUFBAU HDI (Standard)

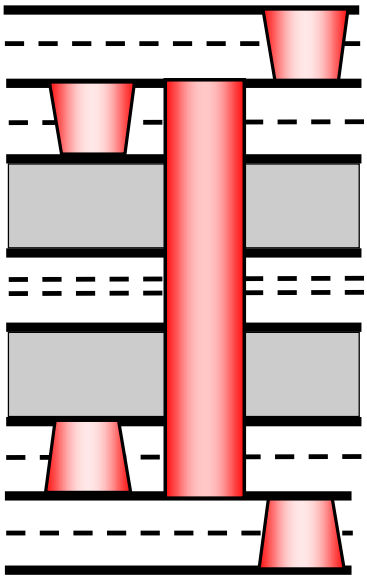
HDI08_2+4(6b)+2_1,00_35

8 - Lagen

Kerne: 0,20 mm Cu 35/35 µm

WE-Artikel Nr.:	**2 + 4(6B) + 2**
KUNDE:	

WÜRTH ELEKTRONIK



LAGENBEZEICHNUNG KUNDE	LAGENBEZEICHNUNG WE	BASIS-Material	CU	PREPREG ANZAHL/TYP	ENDDICKE [µm]	KUNDEN-FORDERUNG [µm]
1	TOP/VS	Folie	12 µm	1)	12	
				1 x 1080	**58**	
2	VSK1	Folie	12 µm		**35**	
				1 x 1080	**60**	
3	2		35 µm		**33**	
		0,200 mm			**200**	
4	3		35 µm		**33**	
				2 x 1080	**124**	
5	4		35 µm		**33**	
		0,200 mm			**200**	
6	5		35 µm		**33**	
				1 x 1080	**60**	
7	RSK1	Folie	12 µm		**35**	
				1 x 1080	**58**	
8	BOT/RS	Folie	12 µm	1)	12	

1) Endkupferdicke Außenlagen ca. 50 µm

Gesamtdicke Material: 986

Anmerkung: Werte für Prepreg sind Mittelwerte (der genaue Wert ist von den Leiterbildstrukturen abhängig)

							Datum:	Bearbeiter:
MATERIALDICKE:	**1,00**	+/-	0,08	mm				
DICKE über galv. Endoberfläche	1,08	+/-	0,11	mm				
DICKE über LSM incl.galv.-Kupfer	1,14	+/-	0,13	mm				
Kundenforderung:		+/-		mm	Messstelle:			

Erstellt am	von	Geprüft am	von	Freigegeben am	von	Revision	Seite:
25.04.2006	**S. Keller**	04.05.2006	M.Kress	25.04.2006	R. Schönholz	00	21+